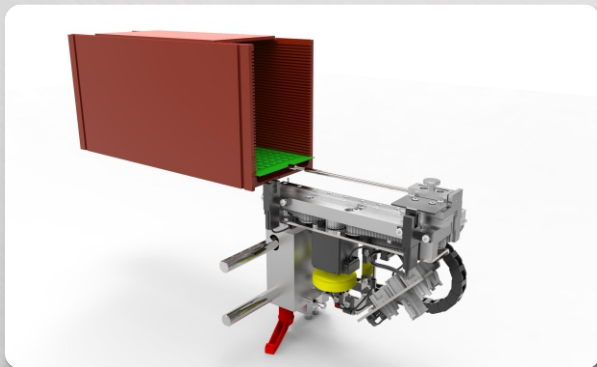


Leadframeindexer

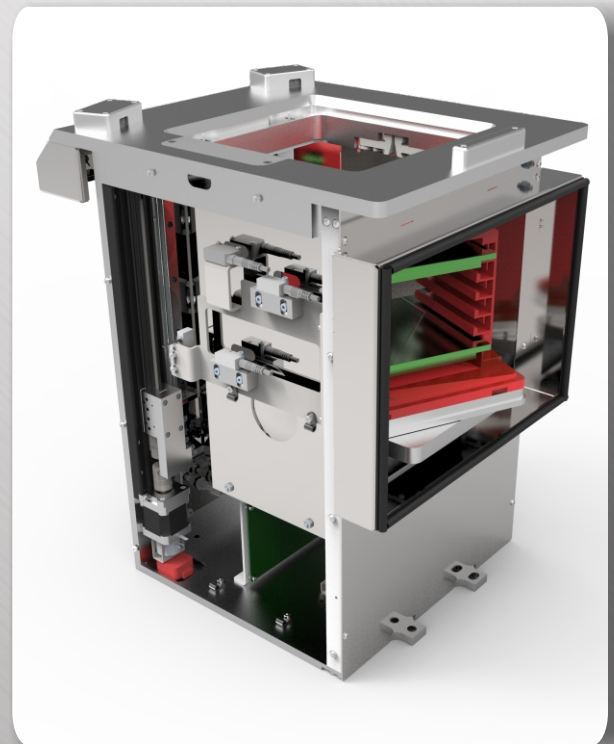
Halbleitertechnik

Baugruppen eines Diebonders

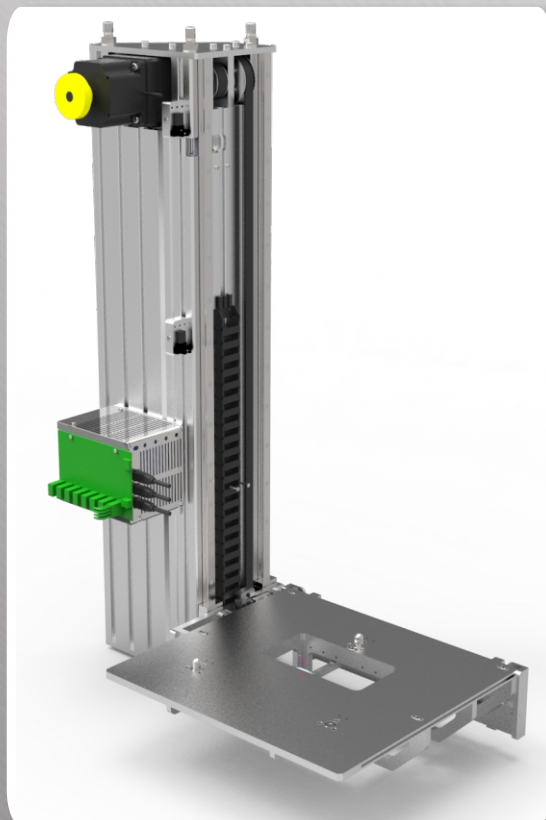
GEMATEC
Engineering GmbH



Pusher



Loadport
eines Speichersystems für Wafer und Reticle



Kassettenlift



HRBT

Halbleitertechnik

Baugruppen eines Diebonders

Aufgabenstellung

Entwicklung eines Indexers:

- Pre-Postheating
- Leadframeanpassung in Dicke und Breite
- Inputpusher und Outputpusher
- Downholder
- Waferkassettenlift
- Heating Rotating Bond Tool

Technische Daten

- Förderstrecke 1200 mm
- Gesamtfördergenauigkeit 0,1 mm
- Höchstgeschwindigkeit 300 mm/s
- Z-Stroke 0,0015 mm

Planung

Überwachung der gesamten Konstruktion in Echtzeit:

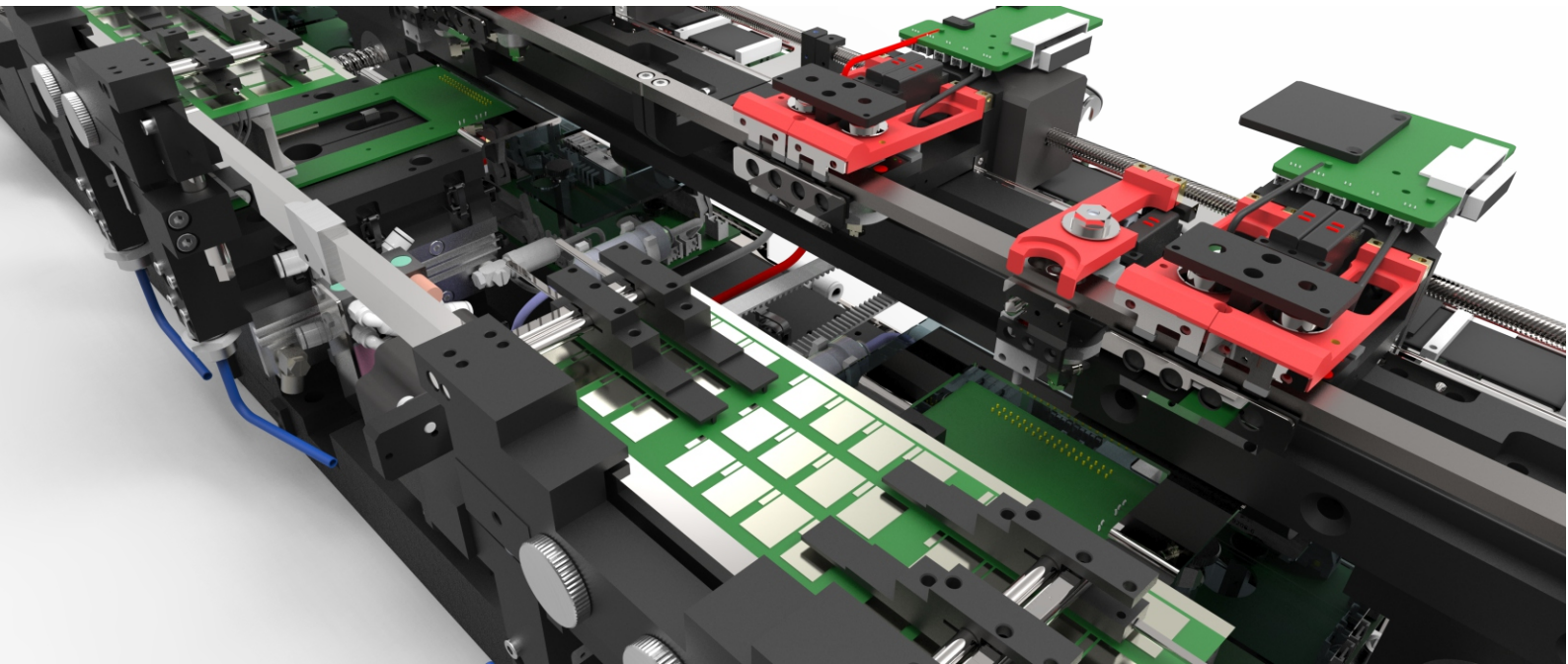
- Mechanik
- Elektronik (PCB)
- Kabel

Modulares Konzept in Hinsicht zukünftiger Maschinentypen.

Konstruktion von verschiedenen Möglichkeiten der einzelnen Baugruppen in Begleitung von Brainstormings, Tools wie:

- FEM (z. B. Modalanalysen)
- Risikoanalysen
- Kostenanalysen

Prototypen herstellen, Tests beschreiben und aufgleisen. Auswerten und analysieren. Weiterentwicklung der Baugruppen bzw. des gesamten Projekts auch in Hinsicht der Kostenreduktion.



Wir arbeiten für:

Boysis GmbH
Cegelec Deutschland GmbH
Pantec Biosolutions AG
EISENMANN AG
Dürr AG
ISA GmbH
Edmund Bühler GmbH
RAMPF Dosiertechnik GmbH & Co. KG
Kulicke & Soffa Industries Inc.
soplar sa
Tec-Sem Group AG

Unsere Arbeitsbereiche sind:

Medizintechnik
Labortechnik
Halbleitertechnik
Fördertechnik
Planung
Design

GEMATEC
Engineering GmbH



Hasenbühlstrasse 8
8500 Frauenfeld
geissner@gematec.ch
www.gematec.ch